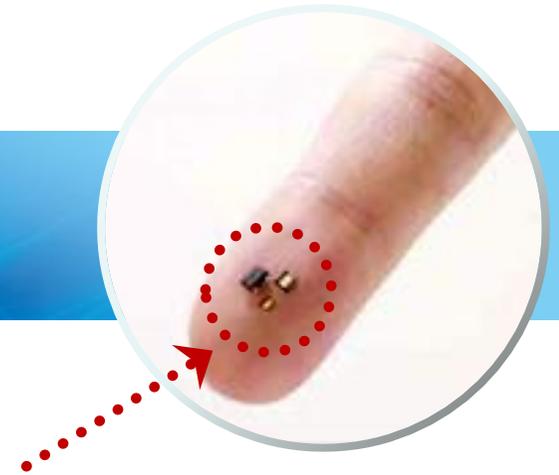


個人投資家向け IRセミナー

「主催：ログミーFinance」



私たちトレックス・セミコンダクターは

小型化・省電力化で

豊かな社会の実現と地球環境の保全に貢献します

2024年11月23日

トレックス・セミコンダクター株式会社

1

会社紹介

2

事業内容

3

2025年3月期 業績・業績予想

4

成長戦略

5

株主還元

会社紹介

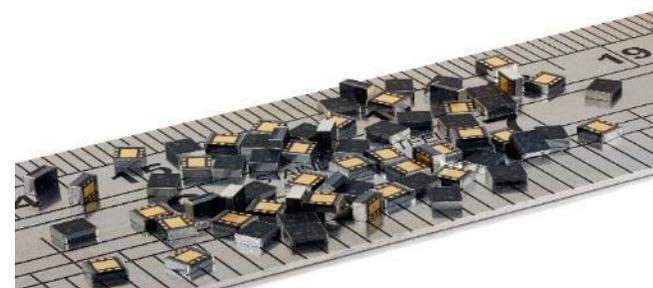
1995年に設立。2014年にJASDAQスタンダード市場に上場、東証二部、一部を経て、2022年4月に東証プライム市場に移行した半導体メーカーです。

アナログのチカラ

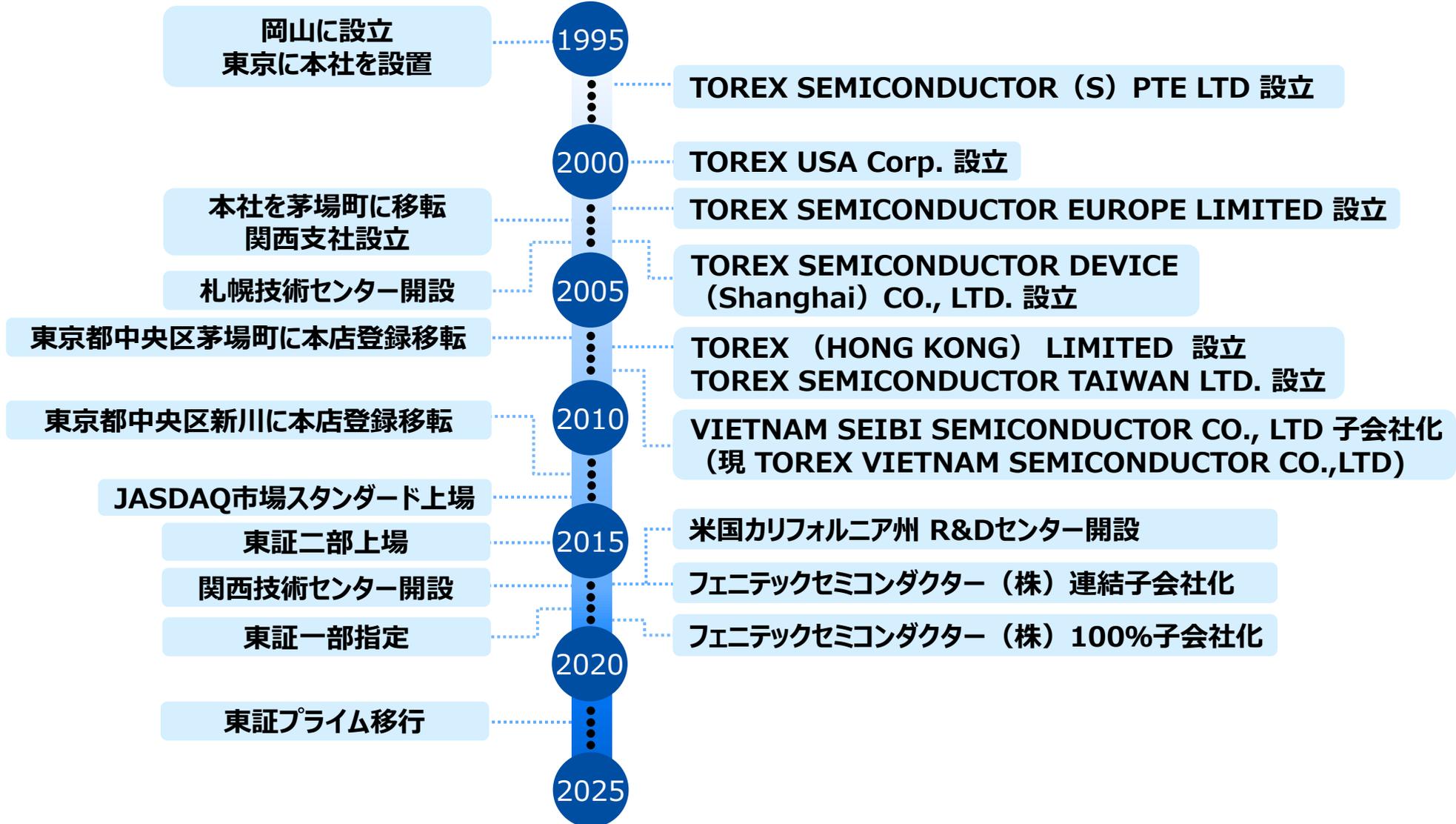
ABOUT TOREX

所在地	東京都中央区新川1-24-1 DAIHO ANNEX 3F
代表者	代表取締役社長 木村 岳史
資本金	29億6793万円（2024年9月30日現在）
事業内容	1.半導体デバイスの開発、設計製造 2.半導体デバイスの販売
従業員数	当社：188名 / グループ：1,040名
上場証券取引所	東京証券取引所 プライム市場
単元株式数	100株
決算期	3月末日
証券コード	6616
URL	https://www.torex.co.jp/

常に豊かな知性と感性を磨き、市場に適応した価値ある製品を創出し、豊かな社会の実現と地球環境の保全に貢献するとともに、私たちの事業に携わるすべての人々が共に繁栄することを企業の理念とする。



電源IC一筋、**省電力・小型化**の技術でエレクトロニクス産業の発展に貢献してきました。



事業内容

TOIREX



トレックス・ セミコンダクター

**ファブレスメーカー
アナログ電源IC専業**

強み

- ・省電力／小型化の技術
- ・蓄積されたアナログ回路ノウハウ
- ・マーケティングと製品企画力
- ・フレキシブルな生産工場
- ・高品質をキープするQC
- ・ワールドワイドの製品販売網

Phenitec
For Further Growth Together



フェニテック セミコンダクター

**半導体受託専業(ファウンドリ)
ディスクリート、パワーデバイス、
CMOSアナログプロセス**

強み

- ・高品質を支える生産ノウハウ
- ・長期安定供給のJapanFab
- ・車載 IATF16949取得工場
- ・専門性の高い製造対応力
- ・オリジナルデバイスの開発力
- ・パワーデバイスの開発力



トレックス・ セミコンダクター グループ

- ・顧客第一に徹した、小回りの利く対応力
- ・積極的なコラボレーションやM&Aによる協力関係の構築

**ファブレス&ファウンドリ
それぞれが本業を突き詰めたプロ集団となり、
相互補完でシナジーを発揮する。**

- 国内に東京本社を含む 8 拠点、海外に9つの拠点を設け、世界の需要に対応しています。



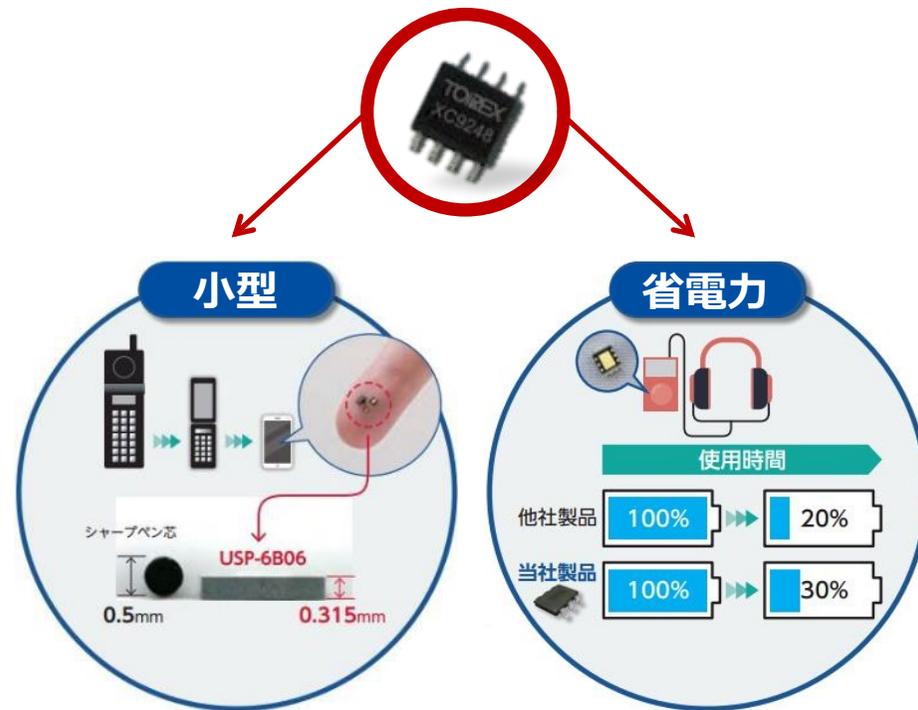
- 世界トップクラスの小型・省電力電源ICを開発・販売しています。

電源ICの役割



電子機器の様々な機能を動かすために
電圧を制御し安定供給する

TOIREXの電源IC



独自の技術で電子機器の
小型化、省電力化に貢献

- 電気を必要とする**機器**には **すべて** 電源ICが使われています



世界は「アナログ」でできている
あらゆるフィールドで採用されるトレックスの電源IC

家電製品	液晶テレビ / 美容機器 / 家庭用ゲーム機 / 生活家電 / ホームシアター / LED照明	産業機器	産業用ロボット / POSレジスター / POS端末 / 工業用測定器 / スマートメーター / セキュリティ機器
医療機器	電子体温計 / 体重計 / 血圧計 / 心電計 / 血糖値計 / モニタリング機器	車載機器	カーナビゲーション / カーオーディオ / パワーウィンドウ / パワーシート / ETC車載機 / ドライブレコーダー用カメラ / バックビューモニター用カメラ
ウェアラブル機器	スマートウォッチ / スマートグラス / スマートカード / ウェアラブルカメラ / ウェアラブル端末	PC関連・コミュニケーション	スマートフォン / PC周辺機器 / デジタルカメラ / ICLレコーダー / ノートパソコン / 電子辞書 / 電子書籍端末 / 携帯ゲーム

- フェニテックセミコンダクターは、国内唯一の半導体受託製造専門メーカーです。

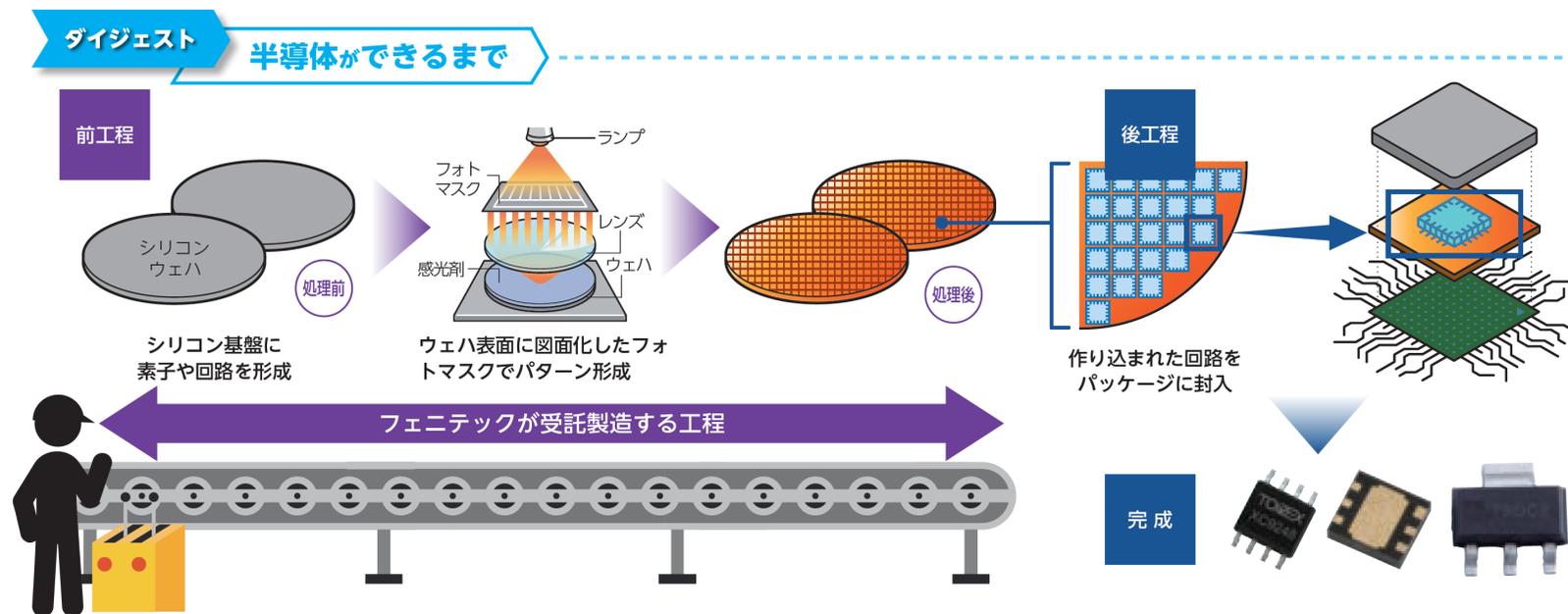
ディスクリートの中でも省エネ性能に優れた**パワー半導体**を主力製品としています。

ディスクリート

1つの機能だけ備えた**単機能半導体**
半導体業界の“ねじ”、“くぎ”のような存在

パワー半導体

電気回路の動作部分で使用され、小さな電力から大きな電力までを扱う。
あらゆる電子機器の省エネ性能を高める半導体



- お客様からの生産受託だけでなく、自社開発のオリジナル製品も提供しています。

前工程(ファンドリーサービス)				
生産			部分加工	
自社開発品 =オリジナル製品		生産受託品 =カスタム製品		生産受託品 =カスタム製品
既存製品を提案/提供	お客様の要望にあわせてカスタム製品を開発/提供	自社保有のプロセスを利用してお客様設計製品を生産	お客様からプロセスと設計を移管していただき、お客様製品を生産	ウェハー生産の一部を加工処理



岡山第1工場



鹿児島工場



お客様のニーズに基づいたファンドリーソリューションを提供することで低コスト・高品質の製品を実現

※ファンドリー：顧客から半導体の製造工程を受託し、顧客の設計データに基づいて半導体を製造する会社

	トレックス・セミコンダクター	フェニテックセミコンダクター
事業形態	ファブレス	ファンドリー
主な製品	<p style="background-color: #FFD700; text-align: center; padding: 5px;">省エネに貢献するキーデバイスを提供</p> <p>電源IC</p>	<p>ディスクリート パワー半導体 (SiC、GaN、酸化ガリウム)</p>
今後の重点市場	<p>産業機器 5G、IoTモジュール 全固体電池モジュール</p> <p>車載機器 自動運転、ADAS、車載カメラ 電子ミラー他、様々なECU</p>	<p>産業機器 産業用ロボット、鉄道、インバータ 発電施設（風力・太陽光）、パワーコンディショナー</p> <p>車載機器 EV向けパワー半導体 電装品</p>



5G



IoT



自動運転



EV

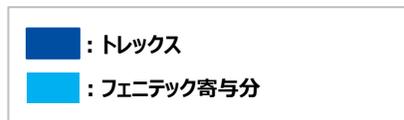
2025年3月期 業績

(単位：百万円)

	24.3期 上期実績	25.3期 上期実績	対前年同期比 増減率
売上高	13,252	12,524	▲5.5%
営業利益	89	336	277.2%
営業利益率	0.7%	2.7%	2.0pt
経常利益	▲266	69	—
親会社株主に 帰属する中間純利益	▲199	5	—
EPS (円)	▲18.15	0.51	—
海外売上高比率 (*1)	68.0%	70.2%	2.2pt
平均為替レート (1\$=)	¥141.3	¥152.2	7.7%
減価償却費	924	1,089	17.8%
設備投資	2,377	1,696	▲28.6%

(*1)海外売上高比率：外貨建て売上比率

(単位：百万円)



➤ トレックス

- 中国市場は回復傾向にあるものの、日本・欧州市場の落ち込みにより減収
- 産業機器、一般民生機器分野が減少

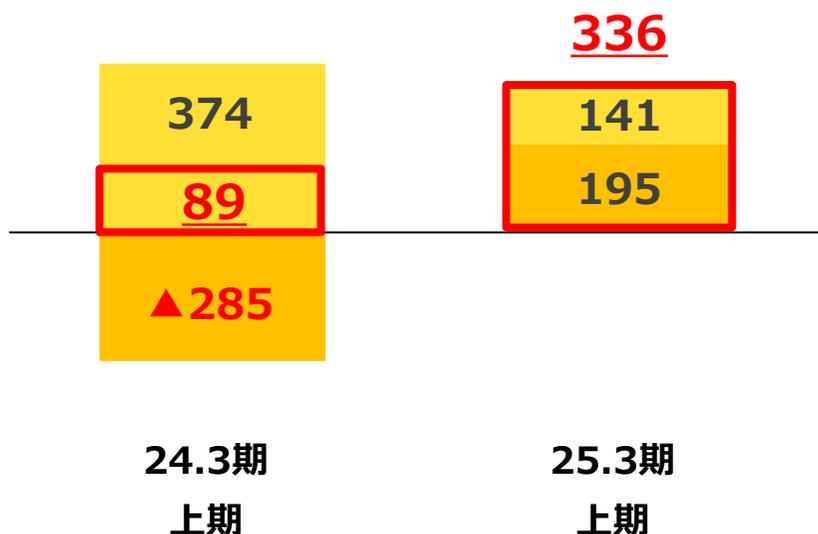
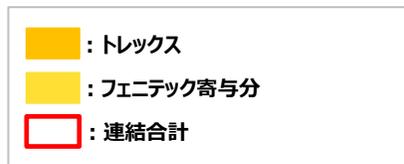
➤ フェニテック

- 中国市場は回復したが、それ以外の地域が減少し、減収
- 産業機器、車載機器分野が減少

(単位：百万円)

	24.3期 上期実績	25.3期 上期実績	対前年同期比増減率
売上高	13,252	12,524	▲5.5%

(単位：百万円)



➤ トレックス

- 為替の影響と棚卸評価損の戻りが発生し、増益

※前期：棚卸評価損の発生 570百万円
 当期：棚卸評価損の戻り 310百万円

➤ フェニテック

- 売上の減少に伴い、減益

(単位：百万円)

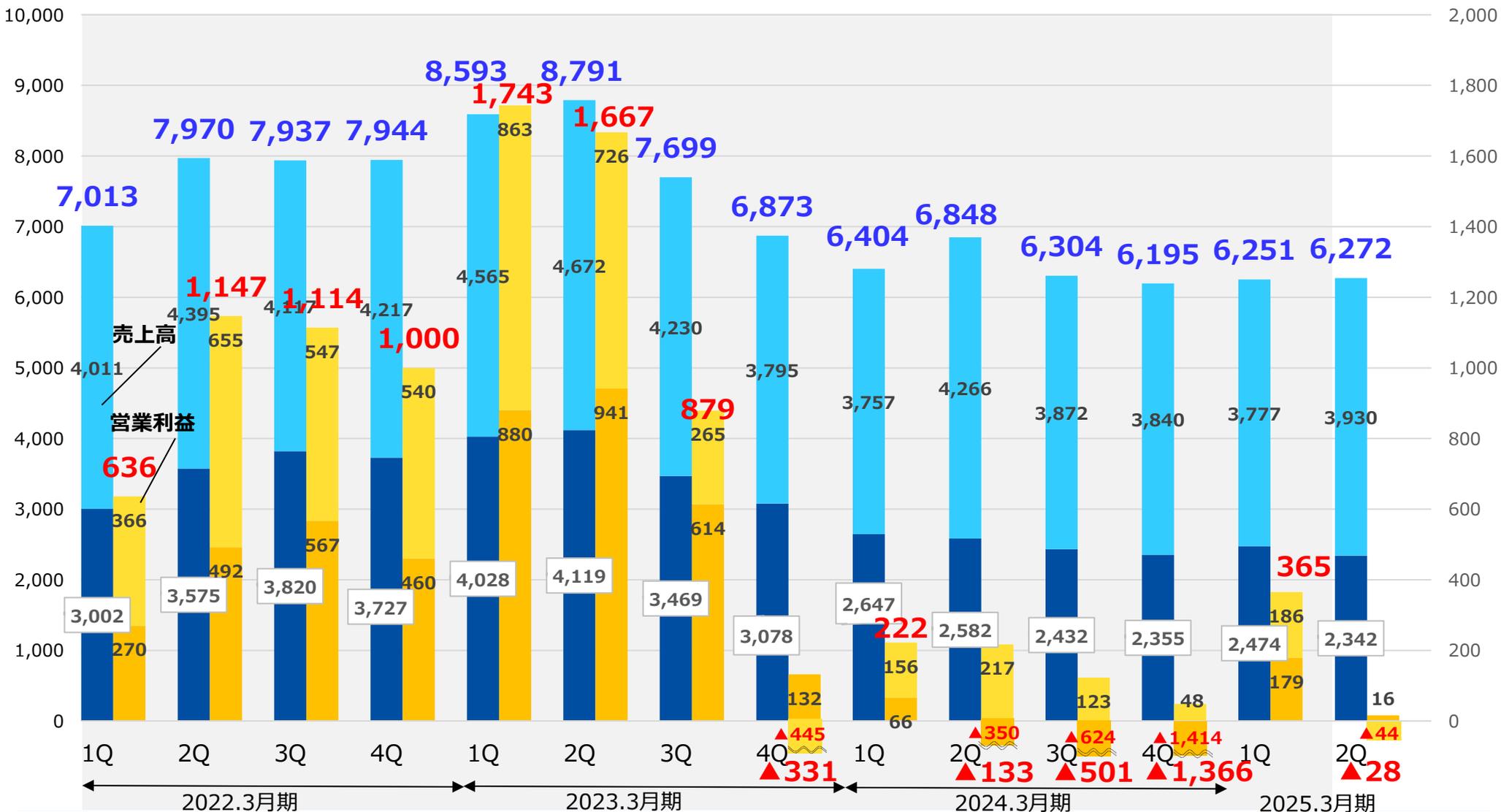
	24.3期 上期実績	25.3期 上期実績	対前年同期比増減率
営業利益	89	336	277.2%

売上高・営業利益の四半期推移



(左軸：売上高) トレックス : ■ ■
 (単位：百万円) フェニテック : ■ ■

(右軸：営業利益)
 (単位：百万円)



2025年3月期 業績予想

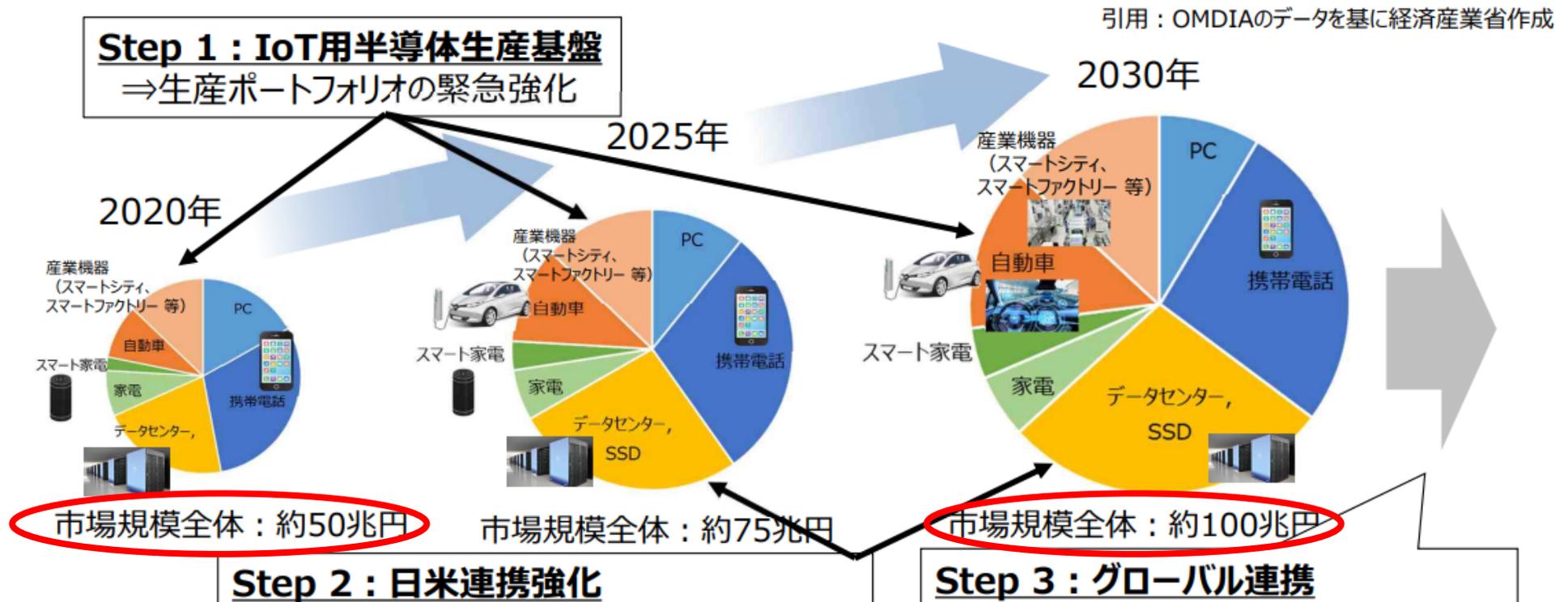
市況の回復遅れに伴う在庫調整の長期化による売上の減少と為替差損の発生により、通期予想を下方修正

(単位：百万円)

	24.3期 通期実績	25.3期 業績予想 (当初)	対前年 同期比 増減率	25.3期 業績予想 (11/14)	対前年 同期比 増減率
売上高	25,751	28,000	+8.7%	25,000	▲2.9%
営業損益	▲1,778	1,000	-	400	-
営業利益率	-	3.6%	-	1.6%	-
経常損益	▲2,452	1,000	-	100	-
親会社株主に 帰属する当期純損益	▲4,297	700	-	0	-
EPS (円)	▲390.73	63.63	-	-	-
平均為替レート (1\$=)	¥144.4	¥150.0	-	¥150.0	-
減価償却費	2,350	3,000	+27.7%	2,700	+14.9%
設備投資	5,284	3,600	▲31.9%	3,600	▲31.9%

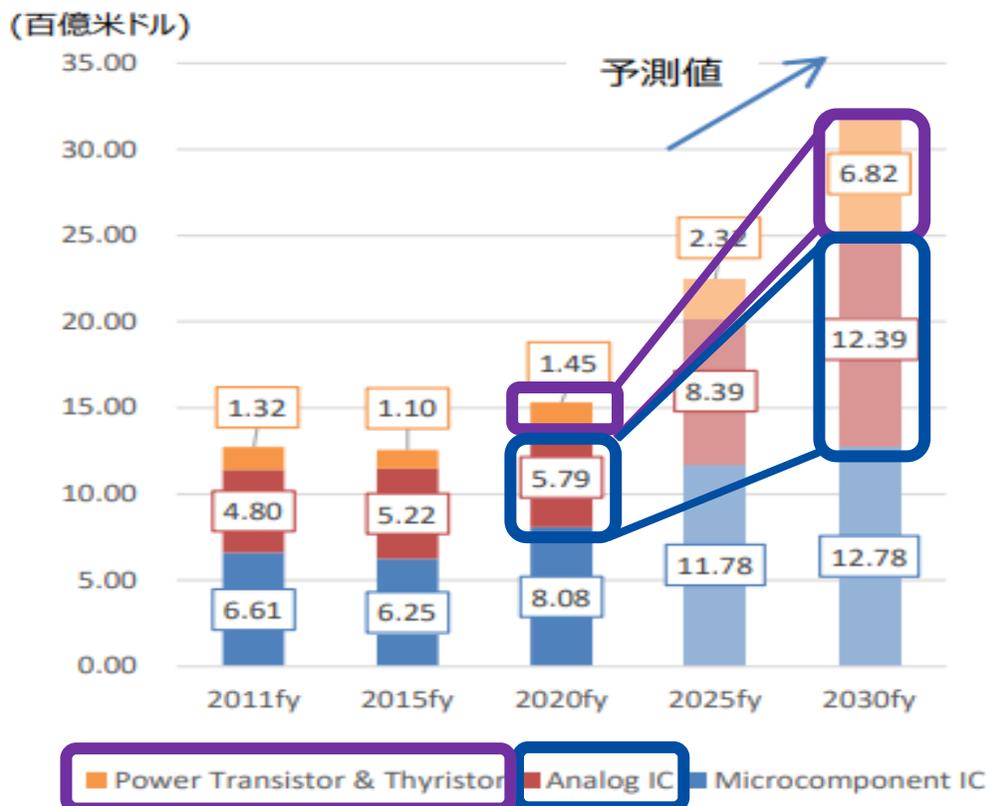
成長戦略

半導体全体の市場規模は、 2020年の**50兆円**から2030年には**100兆円** になると見込まれています。



出典：経済産業省 半導体・デジタル産業戦略

**トレックスの製品群が含まれるアナログICは
2020年の\$5.8億から2030年には\$12.4億に（2.1倍）**
**フェニテックの主力製品であるパワー半導体は
2020年の\$1.5億から2030年には\$6.8億に（4.7倍）**



レガシー半導体の出荷動向

出典：経済産業省 半導体・デジタル産業戦略



トレックスの成長戦略



**電力変換効率の高い
DC/DCコンバータ製品の開発
強み：「小型」「省電力」「低ノイズ」**

小型／高効率／低電圧出力／低ノイズを凝縮した
“micro DC/DC”コンバータ

コイル一体型 XCLシリーズの紹介

● 豊富な構造で、適材適所に対応するTRXの “ micro DC/DC ”

- ・ DC/DCコンバータとコイルを一体化することで、基板の実装面積を削減
- ・ 低ノイズ、小型、高放熱に優れ、あらゆるシーンで高効率で安定した電源回路構成が可能
- ・ 中高耐圧／大電流化に向け、更なる進化を続けています。

構造名	ポケットタイプ	スタックタイプ	マルチプルタイプ	クールポストタイプ
構造図				
構造説明	ICをコイルで覆ってしまう方法	コイル上にICをスタックする方法	コイルとICを横に並べる方法	モールドされたICにコイルをスタックする方法
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 放射ノイズ ◎ 近傍磁界 △ コスト ◎ 実装面積 ○ 大電流 ○ 放熱 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 放射ノイズ △ 近傍磁界 ◎ コスト ○ 実装面積 △ 大電流 △ 放熱 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 放射ノイズ ○ 近傍磁界 ○ コスト △ 実装面積 ◎ 大電流 ◎ 放熱 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 放射ノイズ ○ 近傍磁界 △ コスト ○ 実装面積 ○ 大電流 ◎ 放熱
製品	XCL100/XCL101 (昇圧) XCL102/XCL103 (昇圧) XCL201/XCL202 (降圧) XCL205/XCL206 (降圧) XCL210 (降圧) XCL232 (降圧)	XCL208/XCL209 (降圧)	XCL211/XC212 (降圧)	XCL104/105 (昇圧)

小型 / 低EMIを実現する TOREXのコイル一体型 "micro DC/DC"

■ TOREX 独自のコイル一体型 "micro DC/DC" XCLシリーズ

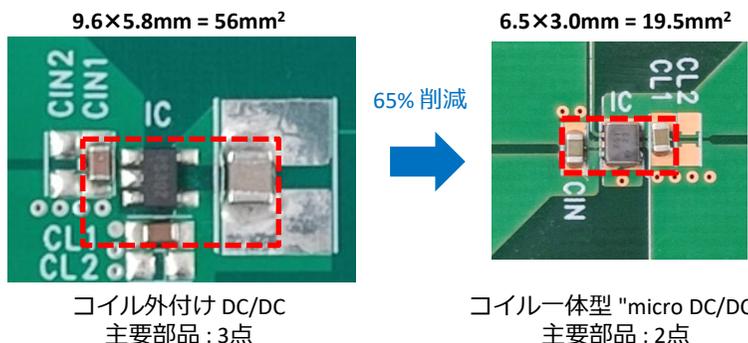
● トレンド、狙い

- 機器の安定動作のためには、MCUや FPGA等の直近に電源 ICを配置することが重要。特に複数電源が必要なケースでは POL (Point of Load) に適した電源 ICの選択が課題。
- ICを含めた電源回路の小型化や、低 EMIが必須。

● TOREXの提案 : コイル一体型 "micro DC/DC"

➢ 電源回路の大幅な小型化

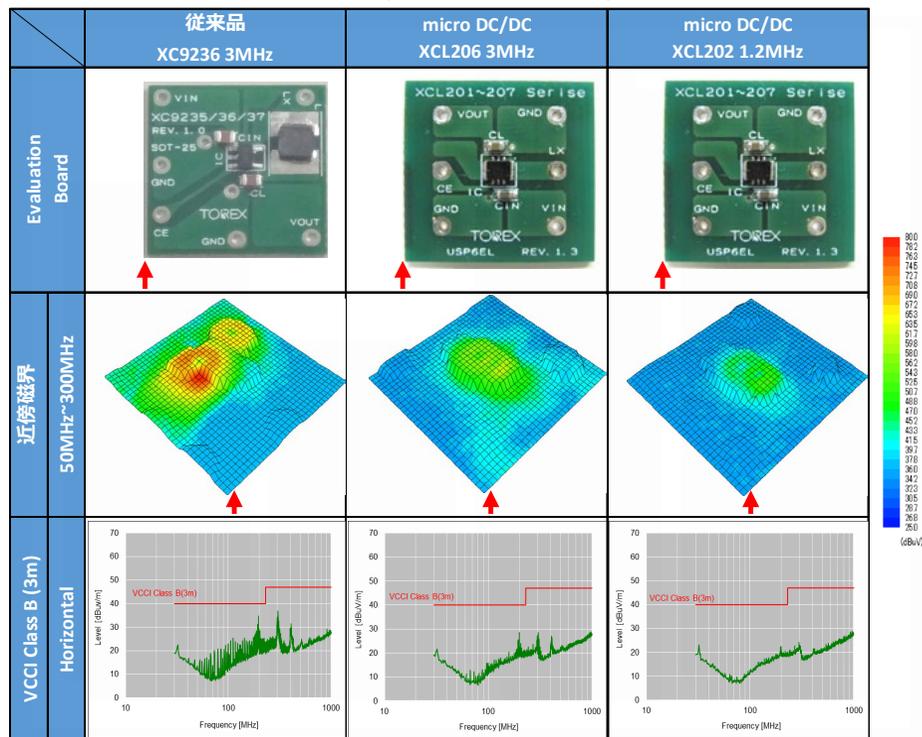
- 大幅な実装面積の削減を達成し、最小クラスの電源ソリューションサイズを提供。
- 独自のパッケージ構造 / 搭載 ICに最適なインダクタ特性。
- IC/コイルを低抵抗で基板接続する構造で高放熱性能。



➢ 独自のコイル一体型構造による、EMI低減

- ✓ ICをコイルで覆うポケットタイプ構造や最適配置により、IC単体と比べて **放射ノイズ** を大幅に低減可能。
- ✓ 通信チップ/センサー等の直近にも配置でき、小型化に貢献。

■ コイル一体型 "micro DC/DC" と単体 DC/DC の EMI比較



トレックスの電源ICは、省電力/小型のスペックが評価されています。

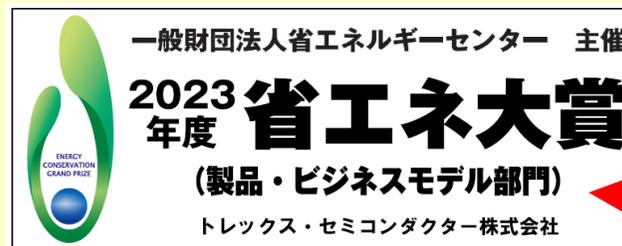
2023年度



日刊工業新聞主催

XC9145シリーズ：昇圧DC/DCコンバータ
回路の消費電流を400nAまで低減したPWM/PFM制御方式を採用することで、軽負荷時、特に数 μ Aの出力電流における電力効率を50~60%改善しました。

奨励賞
受賞



審査委員会
特別賞受賞

XC8110/8111シリーズ：ロードスイッチIC
理想的なダイオードを再現し、チップイネーブル(CE)、過電流制限、突入電流制限、サーマルシャットダウン機能等を搭載したロードスイッチICです。

2022年度



日刊工業新聞主催

XC8110/8111シリーズ
ロードスイッチIC

2020年度



省エネルギーセンター主催

XC9276シリーズ
DC/DCコンバータ

2019年度



日刊工業新聞主催

XC9281/XC9282シリーズ
DC/DCコンバータ

2018年度



経済産業省主催

XC9265シリーズ
DC/DCコンバータ

2018年度



日刊工業新聞主催

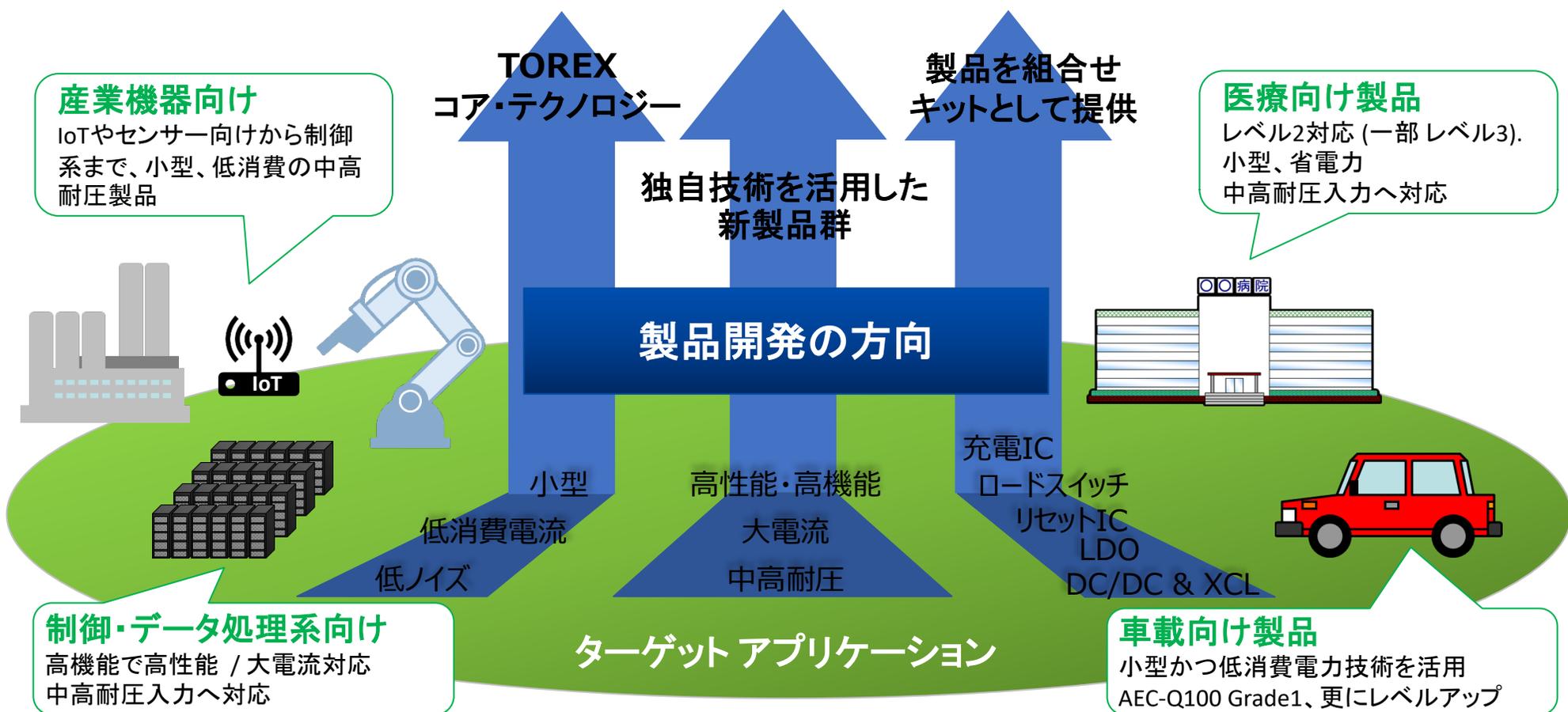
XC6192シリーズ
ロードスイッチIC

トレックスの製品展開

- ・ **ターゲット市場**
- ・ **ソリューション提案**

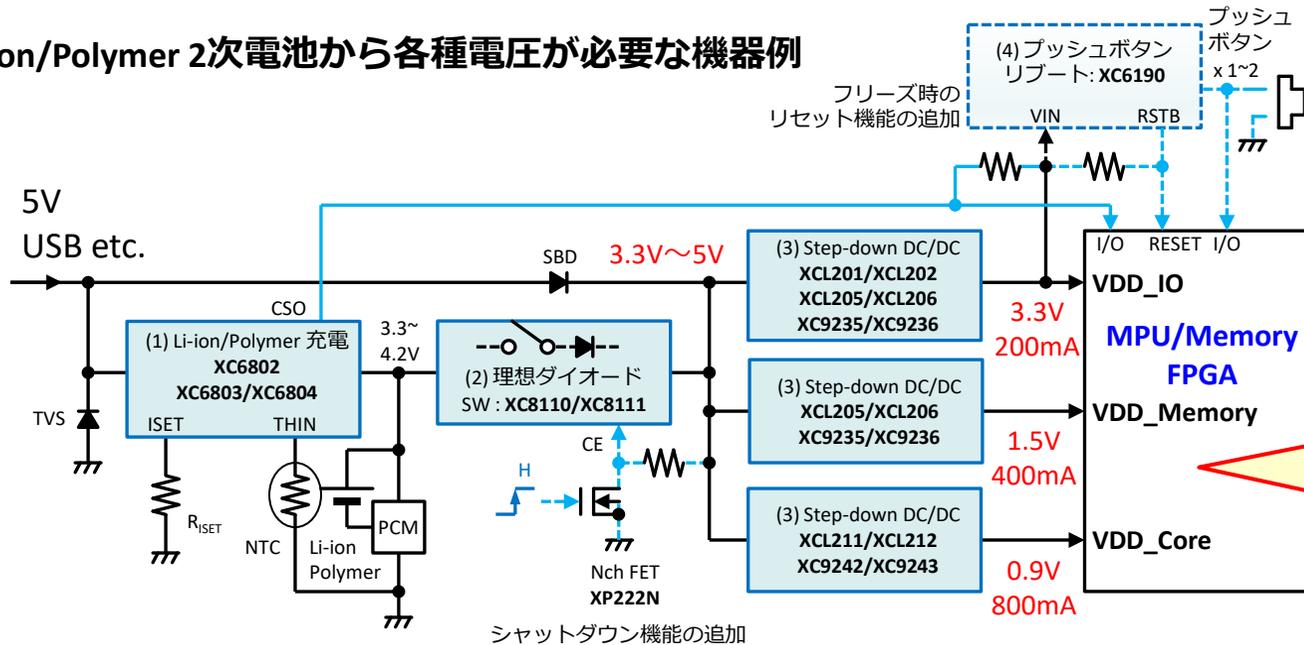
ビジネス／市場にマッチした製品開発の方針

- 持続可能な社会とDXを推進するための最適なソリューションを提供します。
- 小型・低消費電力製品に加え、制御系やデータ処理向けの高性能な電源IC製品を拡充します。
- 特長ある製品を組み合わせたキットを提供することで、システムの電源構成をサポートします。



電源ICの ソリューション例 コラボレーション例

■ Li-ion/Polymer 2次電池から各種電圧が必要な機器例



- ・ 微細プロセス
⇒ コア電圧の低下
⇒ 高速化で電流増加
⇒ 高精度で安定した電源
- ・ 複数の動作電圧が必要
- ・ 待機時の低消費電流

<< トレックスの電源ICの特長 >>

- ・ 0.5Vから出力電圧を設定可能
- ・ 低電圧出力でも高効率を得られる、DC/DCコンバータの豊富なラインナップ
- ・ ナノアンペアの消費電流で動作する電源IC
- ・ VD, LDO製品も低電圧・低消費電流対応

UNDER DEVELOPMENT

■ XCL233 - VSET機能付き、コイル一体型 超低消費降圧 "micro DC/DC"

- コイル一体型で小型化 / 設計容易化 / 低EMI
- 200nAの超低消費で $I_{OUT}=10\mu A$ でも 80%以上の高効率
- VSET機能でさらなる低消費電力

• V_{IN}	: 1.8V ~ 6.0V
V_{OUT}	: 0.5V ~ 3.6V : 2値 VSET端子 H/L で選択
I_{OUT}	: 150mA
I_q	: 200nA
Control	: PFM
Topr	: -40°C ~ 85°C
Package	: CL-2025-03



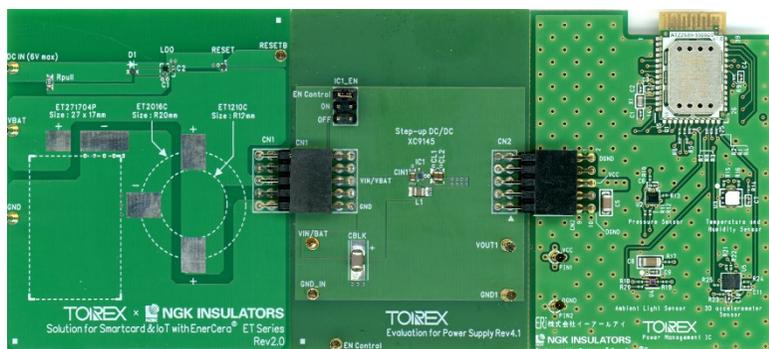
(株)イーアールアイ、日本ガイシ(株)、トレックス・セミコンダクター(株)

3社の技術を組み合わせ「環境発電デモボード」を2種開発

「環境発電デモボード EsBLE」は、

- ・ 日本ガイシの超薄型・小型リチウムイオン二次電池「EnerCera®(エナセラ)」
- ・ トレックスの超低消費電源IC
- ・ イーアールアイの低消費無線化技術

を組み合わせたボードとなっており、太陽光パネル、振動発電などのエネルギーハーベストで発電した電力にて温湿度、気圧などを測定し、BLE(Bluetooth LE)で送信することが可能です。



EsBLE TYPE1

ハーベストから電池への充電基板、超低消費高効率電源基板、測定、通信、制御のシステム基板に別れており、様々な仕様での検証が可能です。

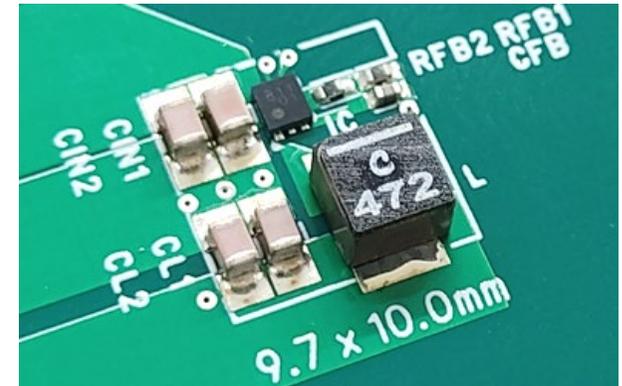


EsBLE TYPE2

必要な機能をすべて実装したオールインワンボードとなります。エネルギーハーベストを接続するだけで、各種センサーでの測定とBLEでのデータ送信が可能です。

PWM/PFM制御 36V高耐圧 600mA 降圧DC/DCコンバータ XC9704/XC9705 シリーズ

- ・ F-PWM、PWM/PFM自動切換制御
- ・ 同期整流 ドライバ FET内蔵
- ・ 入力電圧範囲 3.0V ~ 36V
- ・ SOT-89-5、DFN1820-6G



36V 600mA 降圧DC/DC
小型/低消費ソリューション

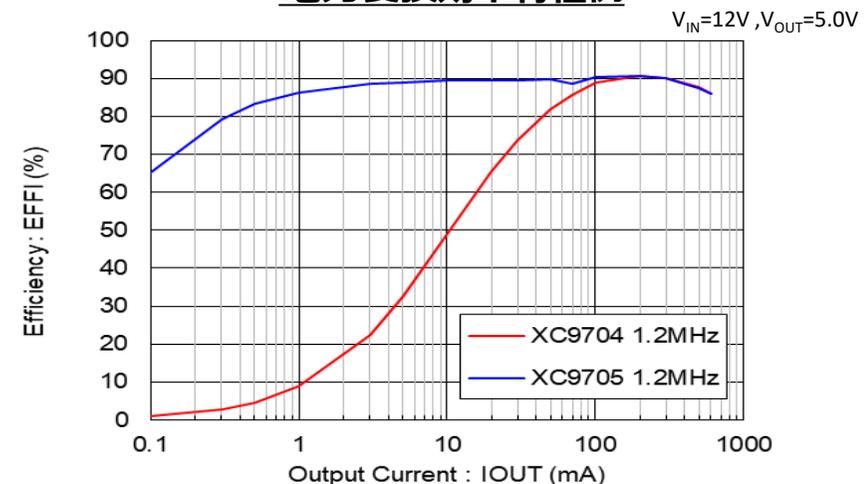
製品の特長

- ・ 高効率、低リップル電圧
- ・ 発信周波数：1.2MHz、2.2MHz
- ・ パワーグッド、UVLO、ソフトスタート外調
- ・ 電流制限、サーマルシャットダウン
- ・ 小型ソリューションを提供

ターゲットアプリケーション

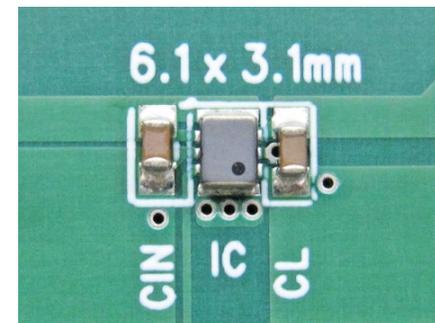
12V/24Vラインからの小型/低消費が必要な機器
工場・ビル・施設などのセンサ/セキュリティ機器
白物家電：エアコン等

電力変換効率特性例



ドライバ内蔵 同期整流 1.0A 昇圧DC/DCコンバータ XCL109/XCL110 シリーズ

- ・ PWM固定、PWM/PFM自動切換制御
- ・ 同期整流 ドライバ FET内蔵
- ・ 入力電圧範囲 0.65V ~ 6.0V
- ・ パッケージ : CL-2025-02



XCL109/XCL110 実装基板

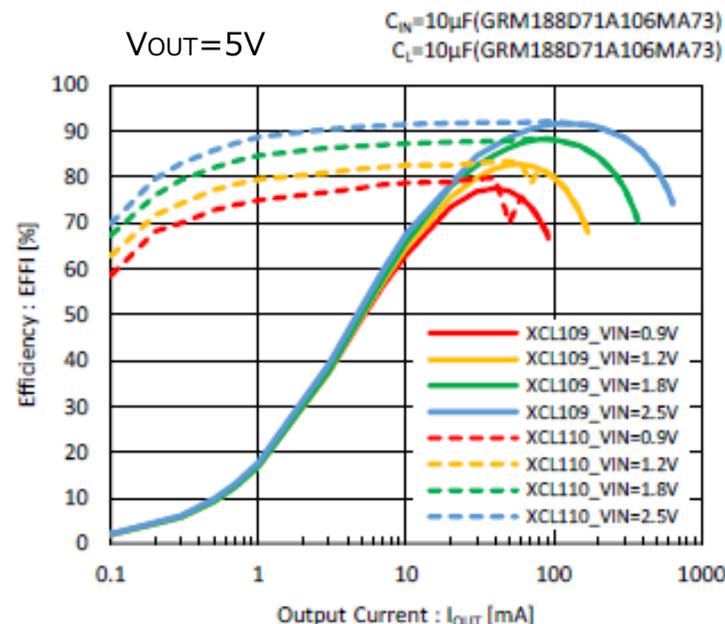
製品の特長

- ・ アルカリ/ニッケル水素電池1本の機器に使用可能
- ・ 発信周波数 : 3.0MHz
- ・ パワーグッド、UVLO 機能付
- ・ サーマルシャットダウン、電流制限、負荷切断
- ・ セラミックコンデンサ対応

ターゲットアプリケーション

ポータブル機器、ウェアラブル機器
美容/健康機器
ゲーム/ホビー、PC周辺機器

電力変換効率特性例



パワーデバイス製品開発

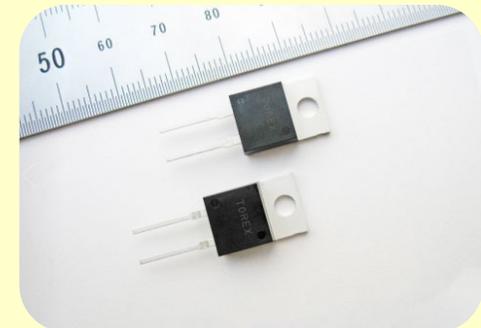
● トレックス 電源ICに加え、パワー半導体製品も強化

パワー半導体事業拡大の専任組織を設置し、強力に推進

- ・ **MOS-FET**ラインナップ拡充（低V_{th}製品、中耐圧大電流製品、低リーク）
- ・ **IGBT** 製品開発の検討
- ・ **SiC** 製品開発推進、製品の具体化
 - ⇒ **フェニテック製 SiC-SBD** トレックスよりPKG品サンプル提供中
 - ⇒ 順次、製品ラインナップを拡大
- ・ **酸化ガリウム**製品開発
 - ⇒ ノベルクリスタルテクノロジー社と共同開発

トレックスでは、フェニテックセミコンダクターが開発した、SiC ショットキーバリアダイオード 850V／10A品のサンプル提供を開始しました。

また、本製品を皮切りに順次 650V～1200Vの製品ラインナップ化を推進しております。



[SiC-SBD TO-220AC XBSC11A108CS](#)



フェニテックの成長戦略



New Vision

2024年1月 ビジョンの刷新

**ファウンドリ事業を通じ
すべてのステークホルダーから信頼されることにより
持続的成長を目指します**

For Further Growth Together

ファウンドリ事業

半導体前工程のウェハプロセス専門のファウンドリ事業を軸・強みとして事業展開を進めていきます。

ステークホルダー

ステークホルダーを、顧客・取引先・社員・株主・地域社会の人々等、私たちに関連するすべての人や団体と定義します。

信頼

会社として個人として、ステークホルダーと**相互に信頼関係にあるパートナー**となることを目指します。

持続的成長

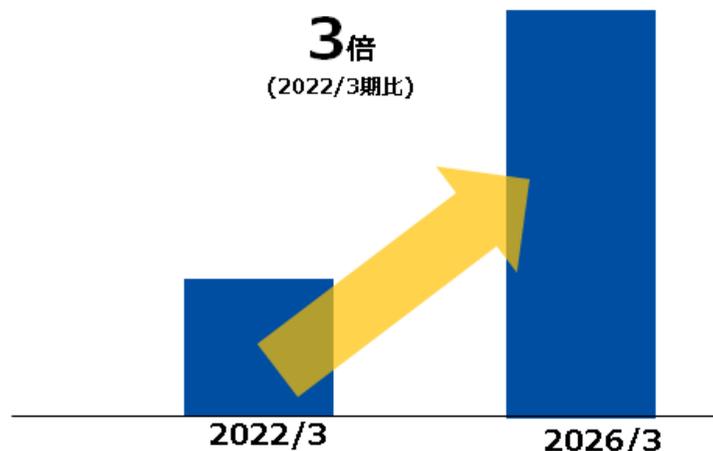
信頼をベースに、ステークホルダーと共に持続的に成長していく企業を目指します。

トレックス メインFABの一つとして鹿児島工場生産能力増強

- ・ アナログ電源IC 生産能力増強
- ・ 生産能力増強に関わる設備投資
3年計画 23.3期~25.3期 総額44億円
(25.3期 投資計画最終年度 10億円)
- ・ 生産装置搬入 稼働開始

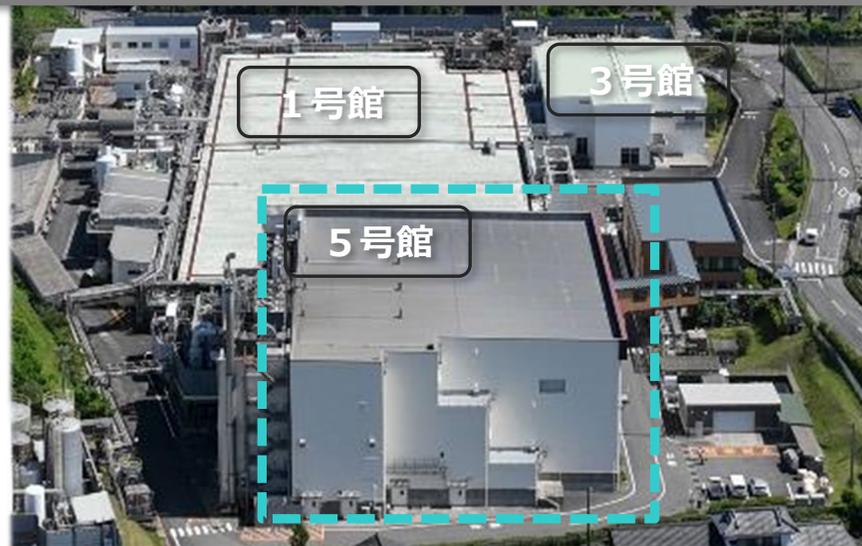


トレックス製品 生産能力枚数推移



トレックス製品の長期安定供給を実現

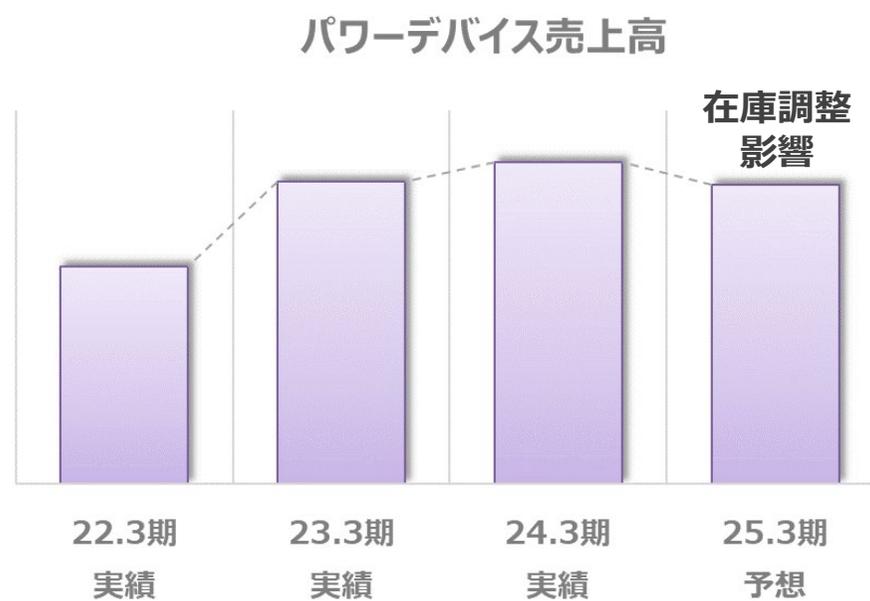
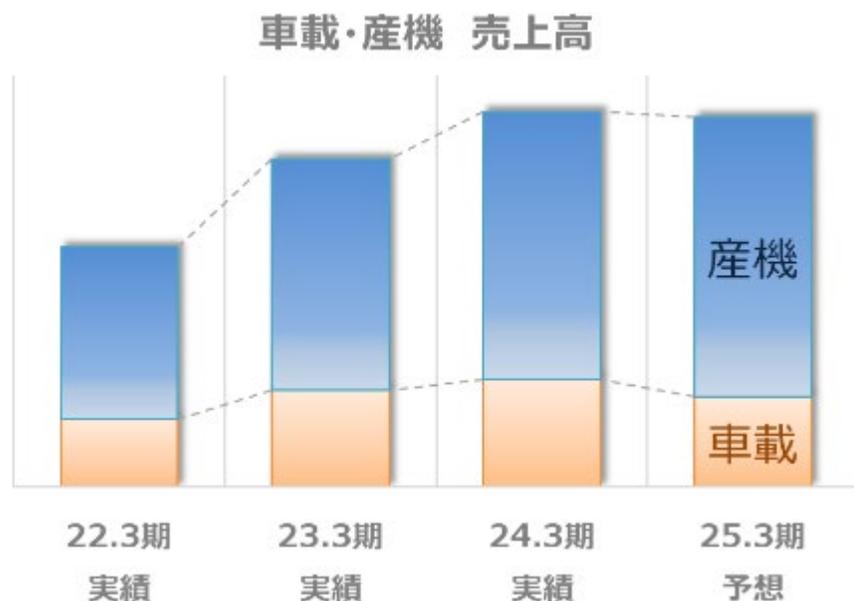
鹿児島工場5号館3階をクリーンルーム化



Siパワーデバイスの受注 市場の在庫調整による影響あり

要因：自動車の電動化、産業機器、5G、新エネルギーなど

デバイス：IGBT、MOSFET



化合物半導体材料に対応したプロセス技術開発 パワー半導体供給ニーズに応える

取扱い：炭化ケイ素 (SiC)、酸化ガリウム (Ga₂O₃)、窒化ガリウム (GaN)

✓市場要求に応えるパワー半導体の開発により更なる売上アップを目指す

SiCオリジナル品

SBD

650V 10A Gen.2,3

650V 6,8,10A Gen.4

650V 20A Gen.2,3

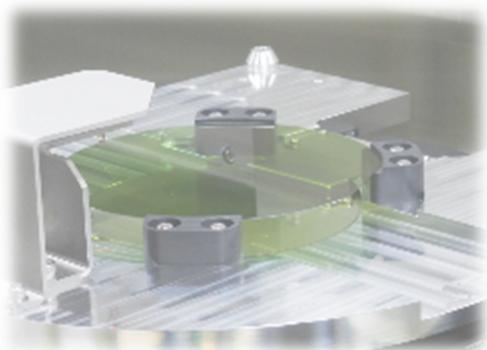
1200V 10A Gen.2,3

- ✓ 今後も市場要望にスピーディなシリーズ拡充で対応
- ・第2,3,4世代 サンプル提供中/顧客評価中

MOS FET

1200V 20A Planar/Trench

- ・プレーナー型 設計完了/サンプル作成
サンプル提供 2024年11月
- ・トレンチ型 開発中



当社設計オリジナル品SBDは
開発を終え、
量産フェーズへ移行しました

SiCファウンドリ事業

MOSFET

- ・ファウンドリ品量産中
- ・新規顧客開拓中

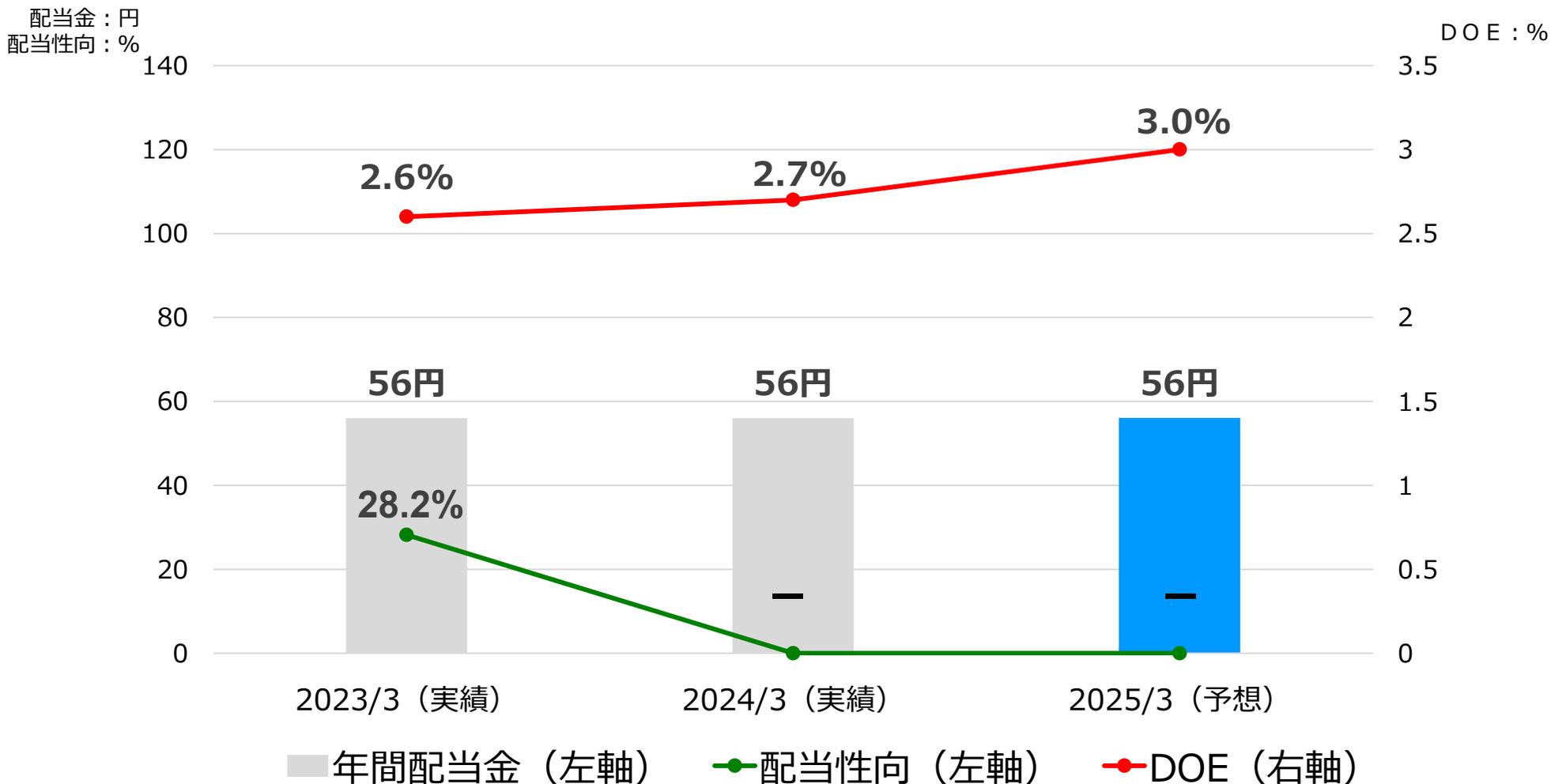
➤ オリジナル品、ファウンドリ品の生産による相乗効果で
付加価値の高い製品・ウエハ加工技術を提供します

株主還元

戦略的投資による成長力の向上を図りつつ、当社を取り巻く経営環境並びに中長期の連結業績及び株主資本利益率の水準を踏まえて実施していくことといたします。

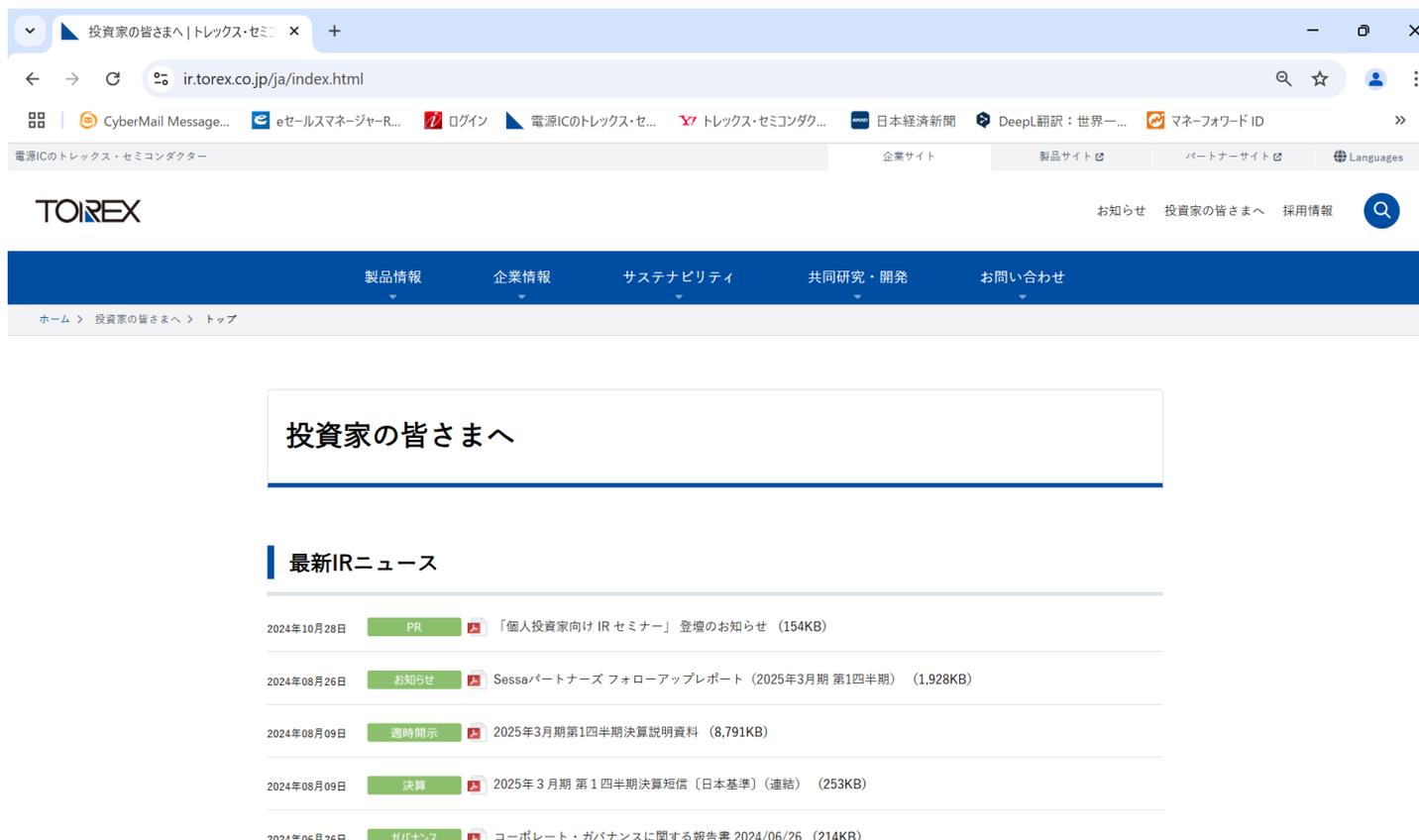
配当につきましては、業績水準を反映した利益配分として**連結配当性向20%以上**、安定的かつ継続的な株主還元
の拡充として**株主資本配当率（D O E）3%程度**を当面の目標として実施してまいります。

連結配当性向20%以上、D O E 3%程度を目標として還元



決算説明会資料、会社紹介動画、レポート等
弊社IRサイトに掲載しておりますので、ご覧ください。

<https://ir.torex.co.jp/ja/index.html>



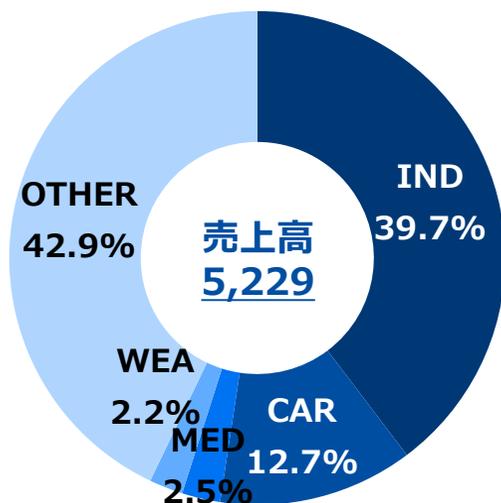
The screenshot shows the TOIREX IR website interface. At the top, there is a navigation bar with the TOIREX logo on the left and a search icon on the right. Below the logo, there are links for "お知らせ" (Information), "投資家の皆さまへ" (For Investors), and "採用情報" (Recruitment Information). The main navigation menu includes "製品情報" (Product Information), "企業情報" (Company Information), "サステナビリティ" (Sustainability), "共同研究・開発" (Joint Research & Development), and "お問い合わせ" (Contact Us). The main content area features a heading "投資家の皆さまへ" (For Investors) and a section titled "最新IRニュース" (Latest IR News). This section lists several news items with their dates, categories, and titles:

- 2024年10月28日 | PR | 「個人投資家向け IR セミナー」 登壇のお知らせ (154KB)
- 2024年08月26日 | お知らせ | Sessaパートナーズ フォローアップレポート (2025年3月期 第1四半期) (1,928KB)
- 2024年08月09日 | 適時開示 | 2025年3月期第1四半期決算説明資料 (8,791KB)
- 2024年08月09日 | 決算 | 2025年3月期 第1四半期決算短信 (日本基準) (連結) (253KB)
- 2024年06月26日 | ガバナンス | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2024/06/26 (214KB)

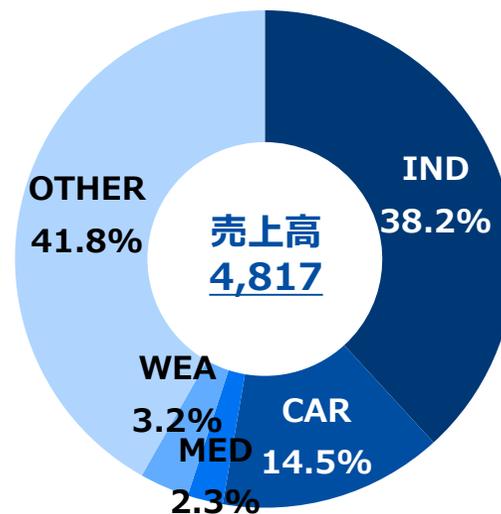
Appendix

2025年3月期 第2四半期業績 ～アプリケーション別売上高（トレックス）

TOIREX



24.3期上期実績



25.3期上期実績

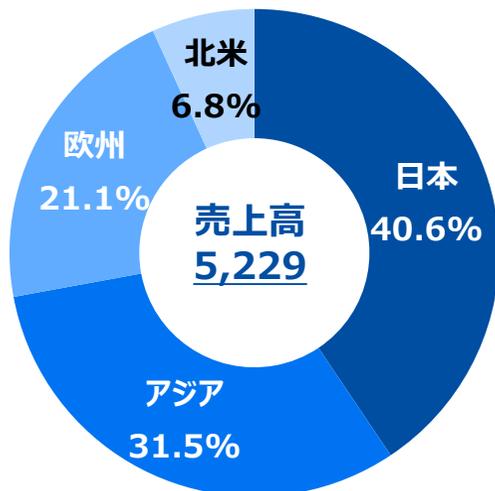
(単位：百万円)

アプリケーション	24.3期 上期		25.3期 上期		対前年同期比 増減率
	売上高	構成比	売上高	構成比	
IND 産業機器	2,078	39.7%	1,842	38.2%	▲11.4%
CAR 車載機器	663	12.7%	699	14.5%	5.4%
MED 医療機器	132	2.5%	112	2.3%	▲15.2%
WEA ウェアラブル機器	113	2.2%	155	3.2%	37.2%
OTHER その他機器	2,243	42.9%	2,009	41.8%	▲10.4%

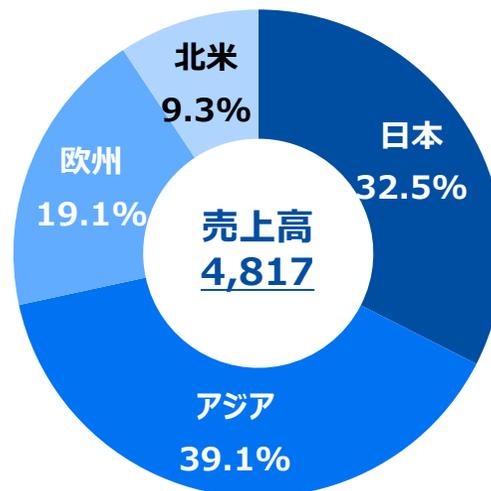
※注：アプリケーションの分類は変更することがあります。

2025年3月期 第2四半期業績 ～地域別売上高（トレックス）

TOIREX



24.3期上期実績

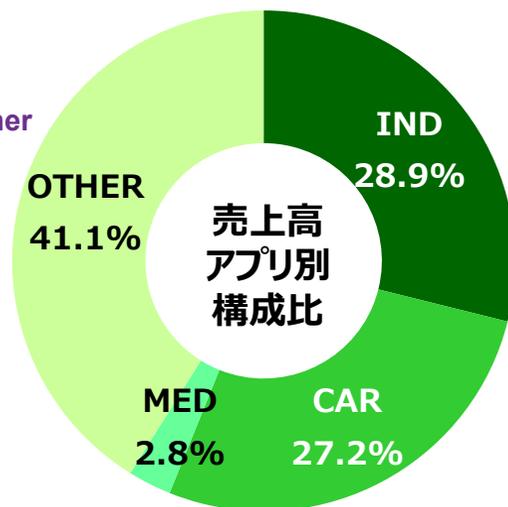


25.3期上期実績

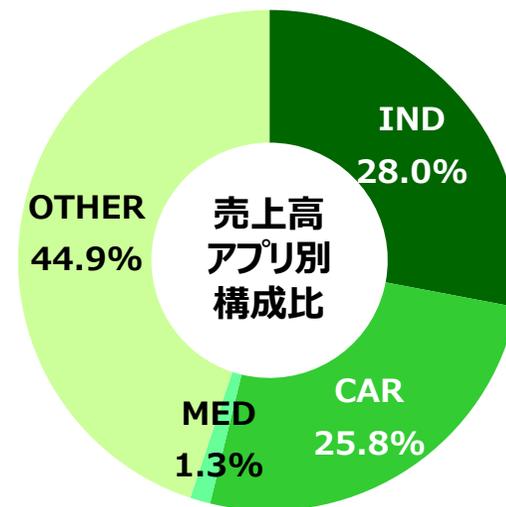
(単位：百万円)

地域 (D-in)	24.3期 上期		25.3期 上期		対前年同期比 増減率
	売上高	構成比	売上高	構成比	
日本	2,125	40.6%	1,566	32.5%	▲26.3%
アジア	1,647	31.5%	1,883	39.1%	14.3%
欧州	1,105	21.1%	921	19.1%	▲16.7%
北米	352	6.8%	447	9.3%	27.0%
平均為替レート (1\$=)	141.3円		152.2円		-

D-in 売上高：デザイン・イン・ベース売上高。当社の製品を搭載した製品が企画・設計され、実質的に受注を獲得した地域をベースとした売上高



24.3期上期実績



25.3期上期実績

(単位：百万円)

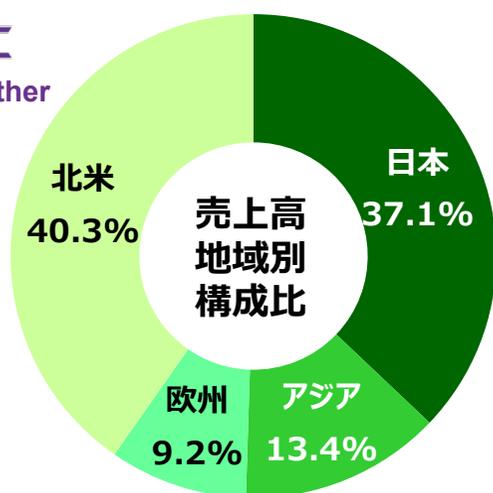
アプリケーション	24.3期 上期		25.3期 上期		対前年同期比 増減率
	売上高	構成比	売上高	構成比	
IND 産業機器	2,479	28.9%	2,317	28.0%	▲6.5%
CAR 車載機器	2,335	27.2%	2,137	25.8%	▲8.5%
MED 医療機器	244	2.8%	110	1.3%	▲54.9%
OTHER その他機器	3,529	41.1%	3,706	44.9%	5.0%

※注：アプリケーションの分類は変更することがあります。

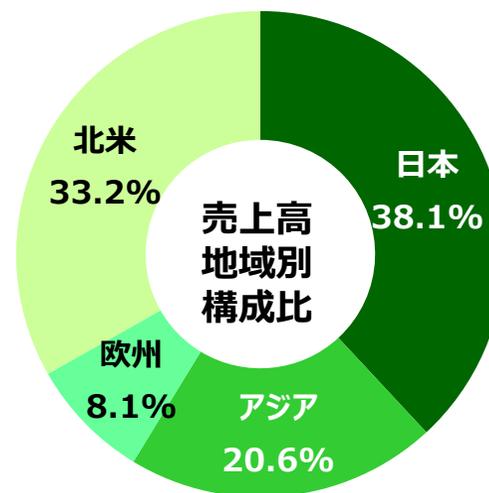
トレックス・セミコンダクター向けの内部取引分を含みます。

お客様から用途を開示頂けない製品は、その他機器に含めております。

2025年3月期 第2四半期業績 ～地域別売上高（フェニテック）



24.3期上期実績



25.3期上期実績

※ 顧客の所在地別に区分しています。

(単位：百万円)

地域（顧客）	24.3期 上期		25.3期 上期		対前年同期比 増減率
	売上高	構成比	売上高	構成比	
日本	3,191	37.1%	3,147	38.1%	▲1.4%
アジア	1,152	13.4%	1,705	20.6%	48.0%
欧州	787	9.2%	672	8.1%	▲14.6%
北米	3,457	40.3%	2,746	33.2%	▲20.6%
平均為替レート（1\$=）	141.3円		152.2円		—

※注：日本には、トレックス・セミコンダクター向けの内部取引分を含む

Powerfully Small !

CMOS電源ICとパワーデバイスで
脱炭素社会の実現を目指します。

今までも、これからも。

トレックスグループは、企業理念に「地球環境の保全」を掲げ、
省電力・小型、低損失な電源ICやパワーデバイスの開発
および生産を我々の「強み」として行ってまいりました。
これからも、この「強み」を生かし脱炭素社会の実現に
取り組んでまいります。

トレックスグループの GX とは、

- ・ 電子回路の省電力化と実装基板の縮小化の推進
 - ・ 発熱を抑える低損失パワーデバイスの推進
- により、脱炭素社会を目指すことです。

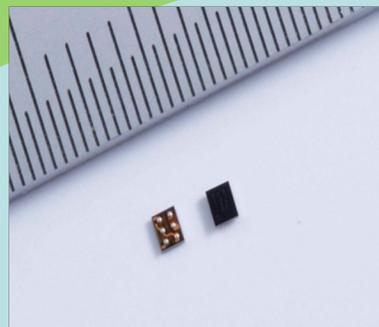
DC/DCコンバータ

省電力回路
部品の小型化
実装基板縮小



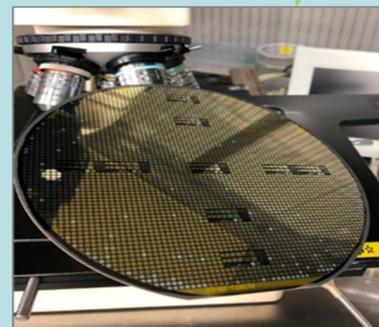
小型パッケージ

部品の小型化
実装基板縮小



パワーデバイス

低発熱
熱損失の低減



脱炭素社会



GXを
半導体で支える
グローバル
企業へ

小型・省電力技術で
社会に貢献する企業から

サステナビリティへの取り組みについて弊社サイトに開示しました。

詳細は以下のサイトをご覧ください。

<https://www.torex.co.jp/sustainability>



本資料に記載された内容は、2024年11月23日現在において一般的に入手可能な情報と、合理的と判断する一定の前提に基づき、当社が作成したものです。

本資料に記載されている当社の中期計画、見通し等に関する記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクと不確実性を内包するものです。

実際の業績は、これらの要素により本資料の記載内容と大きく異なる可能性があります。

投資に関するご決定をされる際、本資料のみに全面的に依拠することはお控えいただき、みなさまご自身のご判断でなされるようお願い致します。

Powerfully Small!

常に豊かな知性と感性を磨き、
市場に適応した価値ある製品を創出し、
豊かな社会の実現と
地球環境の保全に貢献するとともに、
私たちの事業に携わるすべての人々が
共に繁栄すること

